

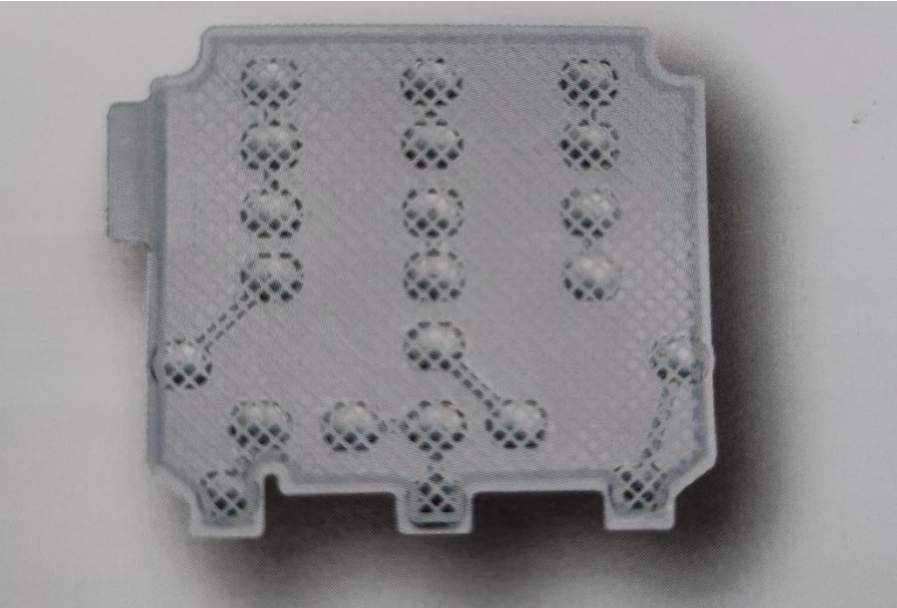
低温固化系列导电银浆-EMI 手机屏蔽专用

导电银浆 BY-2000H

产品简介:BY-2000H 导电银浆料是上海宝银电子材料有限公司(BEMC)生产的一种快干型纯银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成，适用于丝网印刷。

典型应用:主要针对 EMI 屏蔽电路研发的一款产品，可广泛用于手机屏蔽，同样适用于 FFC 柔性印刷电路。

通用特点:有着良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力。



技术指标:

物理性能指标	测试方法	测试标准
外观	肉眼观察	浅灰色胶体
填料		银
气味		轻微
粘度 (Pa.S)	NDJ-7 旋转式粘度计，II 转子，75rpm,25℃	10-20
细度 (μm)	刮板细度计	<10
固含量 (wt%)		60±2%
涂布面积 (cm²/g)	取决于膜层厚度	100-200
固化后性能指标	测试方法	测试标准
附着力	3M810 胶带，垂直拉	无脱落
硬度 (H)	中华铅笔	≥2
工作温度 (℃)	线路温度	<70
电阻 (Ω)	干膜厚 5 μm ± 1 μm，手机屏蔽回路电阻	<1

使用说明及指引:

基材:在 PET 和 PC 等片材上均可使用, 特别适于 PE 基材

搅拌:使用前彻底搅拌均匀。

稀释:本品搅拌均匀后即可使用, 建议不加稀释剂。如需稀释, 需使用专用稀释剂 X-2200 稀释, 建议按小于银浆稀重量比例的 3%进行稀释, 稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准, 产品质量和性能不予保证。

印刷:本品在 PET 和 PC 等片材上均可使用, 固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响, 如网板的大小、张力刮胶硬度、角度和速度、感光浆厚度等

推荐固化工艺:

厚度:干膜 4-6um

丝网:用 200-300 目聚酯丝网或不锈钢丝网

IR 烘道:80Cx2 分钟

烤箱:80Cx30 分钟

储存条件及保质期:

密封保存于干燥、阴凉处, 贮存温度在 5-25C

未开封罐装, 保质期为 6 个月。